

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/038078 A1

- (51) 国際特許分類: C22C 5/06, G11B 7/24, 7/26 C23C 14/34, (74) 代理人: 小田島 平吉, 外(ODAJIMA, Heikichi et al.); 〒107-0052 東京都港区赤坂 1 丁目 9 番 15 号 日本自転車会館 小田島特許事務所 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015294
- (22) 国際出願日: 2004 年 10 月 8 日 (08.10.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2003-356769  
2003 年 10 月 16 日 (16.10.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 石福金属興業株式会社 (ISHIFUKU METAL INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒101-8654 東京都千代田区 内神田三丁目 20 番 7 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長谷川 浩一 (HASEGAWA, Koichi) [JP/JP]; 〒340-0002 埼玉県草加市青柳 2 丁目 1 2 番 30 号 石福金属興業株式会社草加第一工場内 Saitama (JP). 石井 信雄 (ISHII, Nobuo) [JP/JP]; 〒340-0002 埼玉県草加市青柳 2 丁目 1 2 番 30 号 石福金属興業株式会社草加第一工場内 Saitama (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SPUTTERING TARGET MATERIAL

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット材

(57) Abstract: Disclosed is a sputtering target material composed of an Ag-base alloy obtained by adding a specific small amount of P to Ag for alloying. The sputtering target material has a high reflectance and excellent heat resistance.

(57) 要約: 本発明は、Ag に特定少量の P を添加して合金化してなる Ag 基合金から構成された高い反射率を有し且つ耐熱性に優れたスパッタリングターゲット材を提供するものである。

ATTACHMENT H



WO 2005/038078 A1